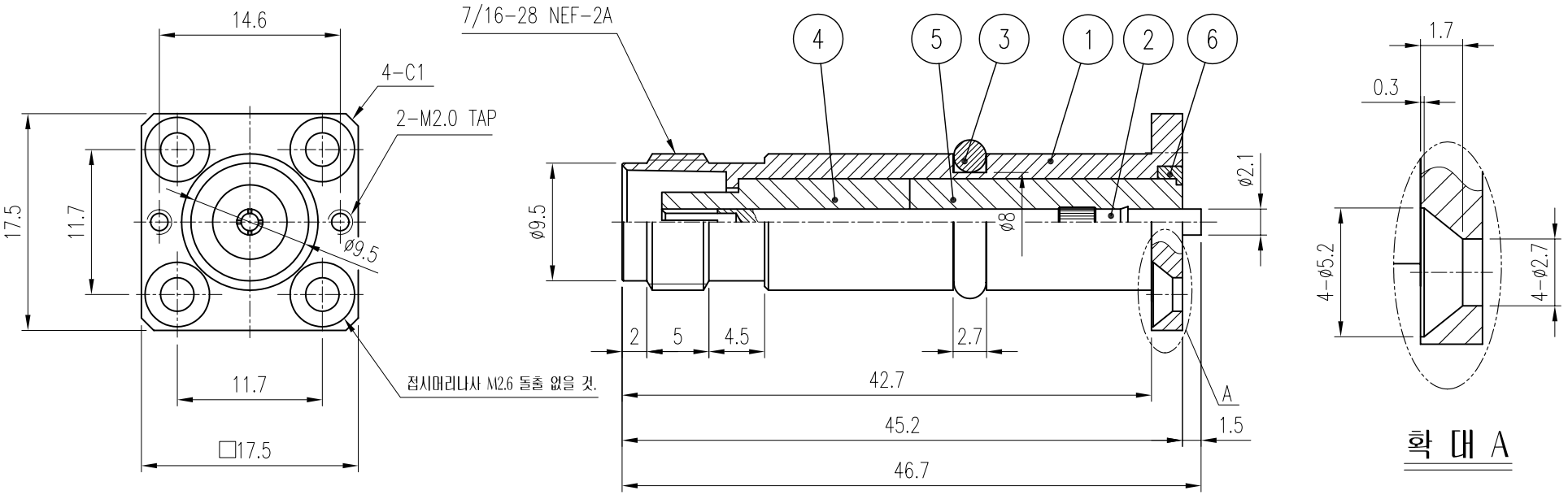
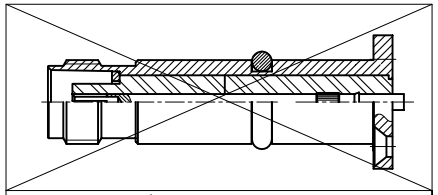
기공 / ST										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	소립성 형상[설변No.연구2007-151] (고정링 억지끼움 변경)	김은희	윤상진	2007. 10. 2.



품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
6	고정 RING	1	MBsBD	SUCO Plate 6㎛	DCV00049-5/1 (L7013)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01235-N/1 (H7095)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01234-N/1 (H7094)
3	GASKET	1	SILICONE RUB	AN-109	DGK00165-N/1 (G7015)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT01451-5/1 (E7087)
1	BODY	1	MBsBD	SUCO Plate 6㎛	DBD01881-5/1 (D7127)



1 설변 전(VER.0)

대체가능재질

공통공차
.* ±0.1
.** ±0.05

재질

열처리

보호피막처리

년월일	2007. 9. 7.		
승인	Y. S. J.		
검도	K. I. C.		
제도	K. E. H.		
작성부서	연 구 소		
척도 2/1	단위 mm	중량	

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 TNC-J-H4-R VER.1

A4

도번 K335-457-001

K335-457-001